

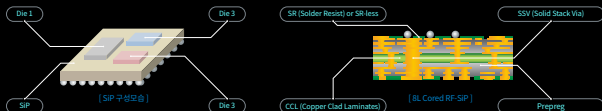
# BGA (SiP Module)

## 개요

## OVERVIEW

다수 IC 및 수동소자를 실장하는 Module용 기판

- Radio Frequency 성능 향상 및 패키지 소형화 가능
- 응용 분야 : 5G 모듈, PA (Power Amplifier), SAW Filter, FEM 등



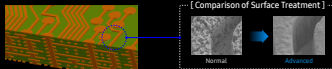
## 핵심 기술

## CORE TECHNOLOGY

Coreless RF-SiP Substrate :  
Thin Substrate 구현



성능 향상을 위한 회로 편차 개선 :  
Low Cu Roughness



## 주요 사양

## KEY SPECIFICATIONS

Layer Structure	Cored	4L~22L
	Coreless	~9L
회로 (Line/Space)		25/25µm
Surface Finish		Direct Au, Thin ENEPIG Selective ENEPIG